

Производители

Altair Semiconductors

Beceem

Fujitsu

Icera

Infineon

Innofidel

Leadcore

Marvell

Qualcomm

Renesas Electronics (Япония)

Sequans уже поставляет LTE-чипсеты для China Mobile, но пока что это сэмплы.

Массовый выпуск ожидается в 2011-2012 годах.

Spreadtrum

ST-Ericsson (аппаратные платформы M700 и M710 – 4 диапазона LTE)

Altair Semiconductors



ALT3100-A0



Altair Semiconductor LTE ExpressCard
UE EC-LTE3100-01
FourGee 3100 / 6200 Cat 3

В сентябре 2010 сообщается о коммерческой доступности реферативного дизайна чипсета LTE для «цифрового дивиденда» (диапазон 20 – 832-862 МГц / 791-821 МГц FDD). Уже проведены тесты IOT (на совместимость). На базе дизайна будет выпускаться чипсет FourGee LTE, который можно будет использовать в USB-донглах, роутерах и т.п. Как ожидается, производство начнется до конца 2010 года.

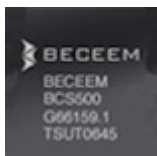
3100 - это процессор, который поддерживает спецификацию категории 3 (100/50 Мбит/с). На чипе есть 20 МГц приемник MIMO и процессор O2P SDR. Чипсет поддерживает и FDD и TDD-LTE. По заверениям компании он прошел тесты на совместимость с оборудованием ряда основных телекоммуникационных поставщиков.

6200 - это высокопроизводительное, широкодиапазонное радио на чипе, также FDD/TDD, способное работать в любом частотном диапазоне 3GPP LTE от 700 до 2700 МГц. Комбинированный чипсет обеспечивает глобальное решение.

Altair Semiconductor выпустила реферативный дизайн TD-LTE для производителей терминалов. Поддерживается частотный диапазон 40 (Индия), 38 (Китай) и набор других диапазонов, которые используются для тестов LTE в Японии, Северной Америке и Европе. Устройство основано на однокристном дизайне с одним стеклом ПО.

Компания Altair договорилась с производителем IPWireless (Сан-Франциско, США) и к концу года ожидается выход модемов USB, способных работать в диапазоне 800 МГц, 1800 МГц и TD-LTE для 2.5 ГГц.

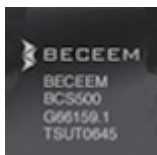
Beceem Communications



BCS500 LTE FDD/TDD и WiMAX

2010.10.13 Сообщается о покупке компанией Broadcom компании Beceem Communications за \$316 млн. Broadcom планирует внедрить технологии 4G Beceem в свою продукцию 2G/3G. Beceem недавно заявляла о платформе 4G, которая способна поддерживать LTE и WiMAX с пиковой скоростью до 200 Мбит/с. [Источник](#)

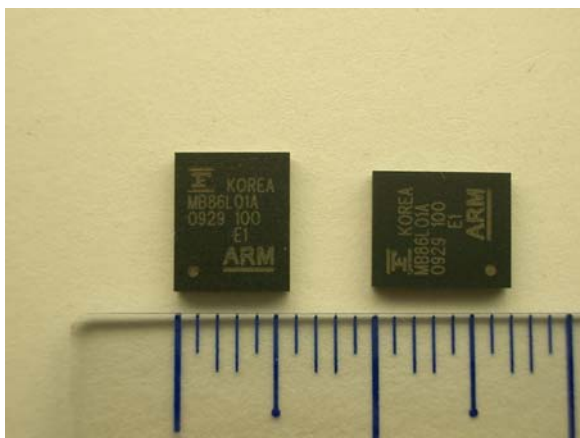
Broadcom



BCS500 LTE FDD/TDD и WiMAX

2010.10.13 Сообщается о покупке компанией Broadcom компании Beceem Communications за \$316 млн. Broadcom планирует внедрить технологии 4G Beceem в свою продукцию 2G/3G. Beceem недавно заявляла о платформе 4G, которая способна поддерживать LTE и WiMAX с пиковой скоростью до 200 Мбит/с. [Источник](#)

Fujitsu



В июне 2010 компания анонсировала одночиповый трансивер MB86L10A способный работать в сетях LTE / 3G / 2G.

GCT Semiconductor



<http://gctsemi.com/html/newsEvents.html>

По словам Дениса Свердлова (Yota) 30.08.2010, компания будет производить чипы для модемов LTE, которые разработаны в компании.

Hisilicon

Выпускает чипы TD-LTE, которые используются, например, в CPE Huawei.

<http://www.hisilicon.com/products/wireless%20terminal/wireless.html>
http://www.huawei.com/broadband/lte/leading_the_track/td_lte.do

Icera



Исера двухрежимный модем
HSPA / LTE

Infineon



SMARTi LU LTE / 3G / 2G мультистандартный RF Transceiver

Innofidei Inc.

Основана в 2006 году в Z-Park Пекина, операции в Пекине, Силиконовой долине и в Тайпее.

21.06.2010 сообщает о начале производства TD-LTE чипсета на базе разработок Cadence Design Systems, Inc.

Чип по технологии 65 нм поддерживает полосу 20 МГц

http://www.innofidei.com/cn/products/channel/products_468.shtml

http://www.marketwatch.com/story/cadence-global-services-enables-industrys-first-td-lte-baseband-chip-from-innofidei-2010-06-21?reflink=MW_news_stmp

Qualcomm

MDM9200 (WCDMA-HSPA, HSPA+ and LTE) (from 11.2009)

MDM9600 (CDMA2000 1x, EV-DO rev.B, SV-DO, SV-LTE, WCDMA-HSPA, HSPA+ and LTE) (from 11.2009)

В частности, поддерживает LTE в диапазоне L.

MSM8960 (CDMA2000 1x, EV-DO rev.B, WCDMA-HSPA, HSPA+ and LTE)

Компания показала использование решения MDM9200 в эфирной демонстрации TD-LTE в сентябре 2010 года и обещает коммерческую доступность MDM9200 и MDM9600 на рынке в середине 2011 года

http://community.livejournal.com/ru_4g/90443.html

Renesas Electronics Corp.

Компания из Японии. В июле 2010 года приобрела бизнес беспроводных ШПД-модемов у Nokia, на работу в Renesas перешло около 1000 инженеров Nokia.

Располагает собственным решением LTE-чипа, намеревается продавать чипсеты (семплинг чипа LTE/HSPA+ намечен на 4Q2010, а массовое производство на 2Q2011).

Планируется, что этот чипсет будет стоять и в одном из телефонов Nokia, выпуск которых намечен на 4Q2011.

Чипсет пока что построен на ARM Cortex R4, не поддерживает DSP.

Runcom

Есть чипсет



Sequans Communications

Производитель чипов TD-LTE. Компания основана в 2004 году. С 2009 года осваивает LTE-технологию.

Контакты

Kimberly Tassin, 425-736-0569 ..2010.10..

Kimberly@sequans.com ..2010.10..

Кадры

Georges Karam, Sequans CEO ..2010.10..

Фотографии устройств



Новости компании

19.20.2010 Сообщается о создании партнерства компаниями Sequans Communications и Huawei с целью разработки и усовершенствования технологии TD-LTE и вывода решений на мировой рынок. Китайские компании уже несколько месяцев ведут совместную работу в этой области и, в частности, провели демонстрацию TD-LTE в Гуаньчжоу в рамках подготовки к 16-м ежегодным Азиатским играм, которые начнутся в ноябре 2010 года. Будет, в частности, оптимизироваться совместная работа модемов Sequans и базовых станций LTE производства Huawei. [Источник](#)

В мае 2010 года компания Sequans сообщила об успешных испытаниях USB-модема TD-LTE на базе своего чипсета SQN3010 baseband SOC в тестах China Mobile в Шанхае. Чип соответствует требованиям 3GPP Rel.8, UE третьей категории (100 Мбит/с с полосой 20 МГц) в 38 и 40 диапазонах LTE. [Фотографии](#).

Skywork Solutions, Inc.

- SKY77706 PAM – модуль усилителя мощности, использованный, в частности, в USB-модеме Samsung GT-B3710.
 - LTE FDD диапазон VII
 - В компоновке для поверхностного монтажа
 - QPSK/16QAM модуляция в полосе от 1.4 до 20 МГц
 - GaAs
- Sky77441 PAM – FDD Band VII, TDD (38 и 40)
- Sky77445 front-end modul для диапазона I
- Sky77455 – IV
- Sky77456 - VII
- Sky77458 – VIII
- Sky77449 и SKY77453 – PAM LTE-FDD для Сев.Америки

http://www.marketwatch.com/story/skyworks-enables-worlds-first-commercial-lte-device-2010-07-12?reflink=MW_news_stmp

ST-Ericsson

M700 (четыре диапазона LTE)

M710 многорежимный, четырехдиапазонный LTE

Wavesat

Odyssey 9000